

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2026年5月7日
地点	深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰先生 董事会秘书：刘丽琼女士 财务总监：朱华燕女士 独立董事：张纯义先生 保荐代表人：张林冀先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、尊敬的董事长好，公司对于重回盈利状态有具体的实现路径嘛，谢谢，非常佩服管理层重资产掌握核心技术的决心，但是还是希望有明确的盈利路径，谢谢</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司已具备射频前端全品类的产品能力，其中，公司国产供应链L-PAMiD系列产品凭借在集成度与性能上的双重突破，已成为驱动公司未来营收增长的“明珠型”产品，其增长可部分抵消市场低迷带来的损失。</p>

目前，公司产品已覆盖RF CMOS、RF SOI、SiGe、GaAs、IPD、SAW、压电晶体等各种材料及工艺，并在Fab-Lite转型过程中逐步积累了IPD、SAW、SOI、BCD、异构集成及其他高频材料及特色高频器件等核心技术矩阵和生产制造能力，深度储备了面向高端射频、卫星通信、光通信等前沿领域的基础工艺技术底蕴。

面对行业周期与经营挑战，公司以异质+异构为核心，构建面向AI时代的物理资源平台，通过全链路协同优化实现工艺与能力的系统性协同。公司将持续夯实6英寸特种工艺、12英寸异质硅基工艺平台、先进异构集成三大工艺基石，筑牢全链条自主可控能力；同时前瞻布局云侧通信、端侧AI、卫星应用等多个未来赛道，以双平台战略为牵引，拓展多元增长空间，支撑公司长期战略转型与高质量发展。感谢您对公司的关注！

2、贵司年报里有提到公司已经全面掌握SLM模组封装核心技术，已在L-PAMiD中实现技术突破并大规模出货。想请问下是否说明贵司L-PAMiD模组在技术上已经对国内其他厂商形成降维打击

A: 尊敬的投资者，您好！作为业界首款实现全国产供应链的L-PAMiD模组，公司L-PAMiD系列产品（主集收发模组）凭借在集成度与性能上的双重突破，已成为驱动公司未来营收增长的“明珠型”产品。

该系列产品深度整合了公司自产的核心器件：依托6英寸晶圆产线自产的MAX-SAW滤波器，以及12英寸晶圆产线自产的射频开关、低噪声放大器，构建了扎实的“设计+工艺”壁垒。作为承载公司未来增长的核心引擎，L-PAMiD产品将持续依托自主供应链的快速迭代优势，在性能与成本上不断进化，加速推进国产射频模组的市场化进程，以前沿技术赋能客户。感谢您对公司的关注！

3、公司未来几年还会持续重资产投入嘛，资产折损何时可以转化成实际的营收，利润何时可以回到正增长，谢谢

A: 尊敬的投资者，您好！短期来看，公司的业绩承压主要因持续的能力建设投入、折旧带动成本费用的增加及供应转化影响、产品结构变化，叠加由AI引发的产业链供给侧需求挤兑和价格上涨及竞争仍然激烈等综合因素影响。

于长期而言，芯卓半导体产业化项目是公司的可持续经营战略，更是公司长远发展的重要基石，未来公司将加速落地资源平台的建

设，专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，力争对标国际头部企业，深度构建核心竞争力。感谢您对公司的关注！

4、你好许总，贵司芯卓12英寸产线进行硅光业务是否需要更换设备？如果需要的话，当前设备是否已经准备就绪？

A：尊敬的投资者，您好！从底层技术逻辑来看，算力中心高速互联领域的光电类核心技术，与射频前端所需工艺存在一定的同源性和共通基础。目前，头部光通信芯片厂商所采用的工艺路线、产线设备与制造体系，与公司自建产线的基础架构上存在相对较高的契合度。依托后期布局建设的优势，公司产线设备与工艺平台也具备一定程度的迭代领先性，为中长期技术延伸、多领域能力拓展奠定了扎实的底层基础。

立足中长期发展战略，公司坚持聚焦射频主业深耕发展，持续筑牢核心业务竞争壁垒。同时，基于平台化发展思路，公司正有序推进高速互联、高端模拟、电源管理等多元技术方向的能力布局与技术储备，持续丰富工艺平台的应用边界。感谢您对公司的关注！

5、关于异构集成工艺进展，2025公司年报披露：相关技术成果已在业务中取得实质性进展，先进集成工艺已实现技术落地和闭环，为未来光电共封等高集成度产品提供核心支撑。请详细介绍一下在业务中取得实质性进展。是产品落地了，还是给客户送样认证，还是获得订单？或者是实现技术落地和闭环，就是贵公司所谓的实质性进展？

A：尊敬的投资者，您好！公司高度重视技术创新与工艺布局，以前瞻性视野重点投资并构建了射频前端领域先进的封装工艺技术平台。依托于12英寸晶圆的异构集成平台，公司着力打造行业领先的模组化解决方案，以高效满足不同市场对下一代器件在性能提升、尺寸小型化及成本优化等方面的综合需求。

截至2025年末，相关技术成果已在业务中取得实质性进展，部分采用先进封装技术的产品已实现规模出货；专为先进集成工艺打造的产线已成功实现从技术落地到规模化量产的闭环，为公司持续深化射频前端模组在小型化、低成本、高性能方向的产品开发奠定了坚实的基础。

公司持续推进有关光通信领域所需的基础工艺技术储备和能力

建设，相关光通信领域产品能力及工艺能力尚处于早期研发阶段，暂未产生收入。感谢您对公司的关注！

6、尊敬的许董事长好，公司12寸和6寸工艺半导体可以生产光电芯片嘛，光通信紧缺的硅光，EML，和电芯片，公司的工艺可以生产嘛，谢谢！

A: 尊敬的投资者，您好！目前，公司6英寸晶圆生产线针对特种材料工艺进行平台建设，12英寸晶圆线以硅基技术平台生产线为基础，致力于异质材料及特种工艺的能力拓展。

关于问题所提及的光通信领域相关工艺的应用，属于公司前沿技术与业务规划范畴。公司将持续关注光通信行业发展趋势，专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，深度构建核心竞争力，充分发挥其长期可持续发展的资源性价值，把握并拓展出更多向其他应用领域和产品的机遇。如有相关重大进展，公司将及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。感谢您对公司的关注！

7、董事长好，公司在光通信的布局可以和投资者分享下，谢谢，公司如何看待光通信的发展，谢谢

A: 尊敬的投资者，您好！目前，公司6英寸晶圆生产线针对特种材料工艺进行平台建设，12英寸晶圆线以硅基技术平台生产线为基础，致力于异质材料及特种工艺的能力拓展。目前，公司在Fab-Lite转型过程中逐步积累了IPD、SAW、SOI、BCD、异构集成及其他高频材料及特色高频器件等核心技术矩阵和生产制造能力，深度储备了面向高端射频、卫星通信、光通信等前沿领域的基础工艺技术底蕴。相关光通信领域产品能力及工艺能力尚处于早期研发阶段，暂未产生收入。

未来公司将加速落地资源平台的建设，专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，深度构建核心竞争力，充分发挥其长期可持续发展的资源性价值，把握并拓展出更多向其他应用领域和产品的机遇。感谢您对公司的关注！

8、许董事长好，公司最近大量招聘光通信领域的博士人才，请问，公司在光通信领域有所突破嘛，谢谢！

A: 尊敬的投资者，您好！一直以来，公司积极布局芯卓半导体产业

	<p>化项目建设，基于长期对高端工艺的积累，公司现已储备了可面向光通信领域的基础工艺技术底蕴积累。目前，公司相关光通信领域产品能力及工艺能力尚处于早期研发阶段。</p> <p>未来公司将加速落地资源平台的建设，专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，深度构建核心竞争力，充分发挥其长期可持续发展的资源性价值，把握并拓展出更多向其他应用领域和产品的机遇。感谢您对公司的关注！</p> <p>9、董事长好，公司股权激励的，基数是多少，公司年报好像没有具体的收入，谢谢了，看了有比较高的增长预期，但是基数没有，谢谢</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司2025年限制性股票激励计划以L-PAMiD出货数量增长率为考核指标，该指标能有效衡量技术创新与成长性。公司综合考量宏观环境、行业趋势及战略规划，设置阶梯归属模式，兼顾成长性与激励效果，有利于调动员工的积极性。最终各年度L-PAMiD出货数量增长率，将以会计师事务所出具的专项报告为依据。感谢您对公司的关注！</p> <p>10、董事长好，公司管理层会增持公司股票，以提升投资者信心嘛，谢谢</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司对股票在二级市场的价格表现保持关注，管理层一贯以竭力做好经营，谋求可持续发展为己任，不断提升内在战略价值，用可持续发展的表现回报广大投资者。未来如有相关计划将按照相关规则及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月7日